

ノンシリコン・低残渣タイプ 基板保護テープ・AP-01

リフロー加熱時の基板表面保護に適した弱粘着テープです。
糊残りが少なく、シリコン成分を含まないので端子部の保護に最適！



特徴

耐熱性に優れています。
粘着剤にシリコン成分を含まないのでワークの電気特性に影響を与えません。
リフロー加熱(260 /30分)後も糊残りがありません。

用途

カードエッジコネクタ(金メッキ端子)部への異物付着防止
ACFパッド部へのフラックス成分付着防止
ボンディングパッド部や種々の端子部の表面保護
テープ残り痕のインクはじき防止

仕様

品番	テープ幅	長さ	厚み
AP-01-19	19mm	33m	0.047mm

12mm幅、25mm幅：供給停止となりました

構造

